

2023年5月23日

各位

会社名 太洋工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 細江 美則
問合せ先

取締役執行役員
役職・氏名 営業本部長 田中 清孝
兼 営業部長
電話 073-431-6311

微細欠陥の検出を強化した外観検査装置「TY-VISION M111SC」

光学分解能2.5 μ m仕様、上市のお知らせ

当社は、外観検査装置「TY-VISION」シリーズの高性能化開発を進めております。このたび、光学分解能2.5 μ m仕様の光学系を搭載した外観検査装置「TY-VISION M111SC」（以下、「本装置」という。）が完成しましたのでお知らせいたします。

近年、DX及びIoT化のさらなる拡大や5G通信網の普及を背景とした社会のデジタル化の進展、自動運転及び電動化をはじめとする自動車産業の変革等に伴い、各種基板が高精細化するなど基板全体の品質レベルが高まっております。このような市場動向の中、検査ニーズに応えるために本装置を開発いたしました。

本装置は光学分解能2.5 μ mを採用したことにより、約10 $\times$ 10 μ mの欠陥（異物・欠け・シミ等）に対して安定した欠陥検出が可能となりました。（対当社従来仕様光学分解能3 μ m比）これは約10 $\times$ 10 μ mの欠陥に対してどれだけのピクセル数で欠陥認識（光学分解能3 μ m：約9ピクセル、光学分解能2.5 μ m：16ピクセル/約1.7倍のピクセル数で認識）するのかということであり、欠陥検出力及び同様の欠陥に対する繰り返し検出精度が向上いたします。なお、実績として当社がターゲットとしている高精細サンプル基板に対し約15%の検出力UPを確認しております。（当社調べ）

10 $\times$ 10 μ mの欠陥に対するピクセル数のイメージ



また、装置構成はクリーンな環境に配慮した構造設計を採用しており、FFU（Fan Filter Unit）が標準装備されております。本装置は光学系と搬送系の基本構成が「TY-VISION A308DC」（当社製自動機）と共通であるため、自動機との並行運用が容易に行えます。

さらに、当社開発のAIシステム「TY-VISION XAIS（ザイス）」をオプション追加することで目視確認工程の省力化と検出力の向上を実現いたします。

今後もさらなる検出力の向上と検査工程の省力化につながる装置開発にご期待ください。

※装置完成に伴い、下記展示会に実機を展示いたします。

ご来場の程よろしくお願いいたします。

JPCA Show 2023 【第52回国際電子回路産業展】

会期：2023年5月31日（水）～ 6月2日（金）

場所：東京ビッグサイト

東展示棟 2ホール：2B-12

JPCA 2023
Show
第52回国際電子回路産業展

来場登録はコチラから ⇒



「TY-VISION M111SC」

以 上